

2010年度(2011年3月期)

第2四半期累計決算説明会



(証券コード:6787)

2010年11月18日

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し、等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なることがございます。

1. 2010年度 中間決算概要

	Page
1－ 1. 上期営業の概況	3
1－ 2. 上期連結決算（2009年度・2010年度）	4
1－ 3. 上期単独決算（2009年度・2010年度）	5
1－ 4. 主な関連部門決算（広州・武漢・宮城）	6
1－ 5. 事業種類別 売上高	7
1－ 6. 電子回路基板 商品・品目別 売上高	8

1-1 上期営業の概況

連結実績

■売上高	38,375百万円	前年同期比 +14.0%
■営業利益	2,009百万円	前年同期比 +29.4%

プラス要因(前年同期比)

- 順調な受注拡大
- 新規取組基板の拡大

マイナス要因(前年同期比)

- 原材料の高騰
- 武漢第2工場の立上遅れ

1-2 上期連結決算

(単位;百万円)

	09年度実績	前年比	10年度実績	前年比
売上高	33,676	-28.6%	38,375	14.0%
営業利益	1,553	-55.4%	2,009	29.4%
営業利益率	4.6%		5.2%	
経常利益	1,118	-65.2%	1,289	15.3%
経常利益率	3.3%		3.4%	
当期純利益	778	-70.0%	873	12.2%
当期純利益率	2.3%		2.3%	
1株当り当期純利益	46.44円		47.32円	

1-3 上期单独決算

(単位:百万円)

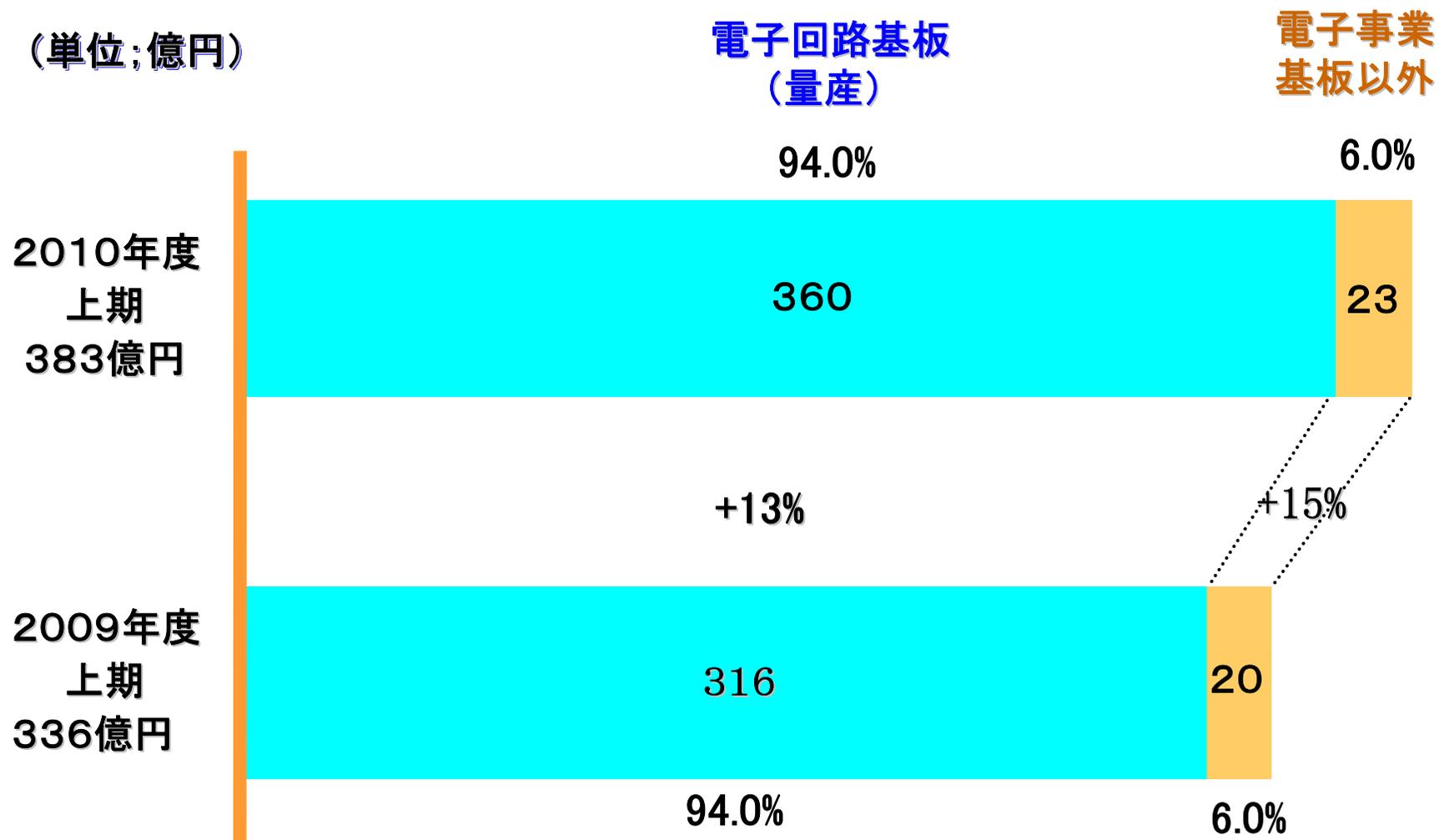
	09年度実績	前年比	10年度実績	前年比
売上高	20,262	-20.2%	23,499	16.0%
営業利益	-418		1,116	367.0%
営業利益率	-2.1%		4.7%	
経常利益	156	-88.7%	509	226.3%
経常利益率	0.8%		2.2%	
当期純利益	122	-84.4%	502	311.5%
当期純利益率	0.6%		2.1%	
1株当り当期純利益	7.30円		30.04円	

1-4 主な関連部門上期決算

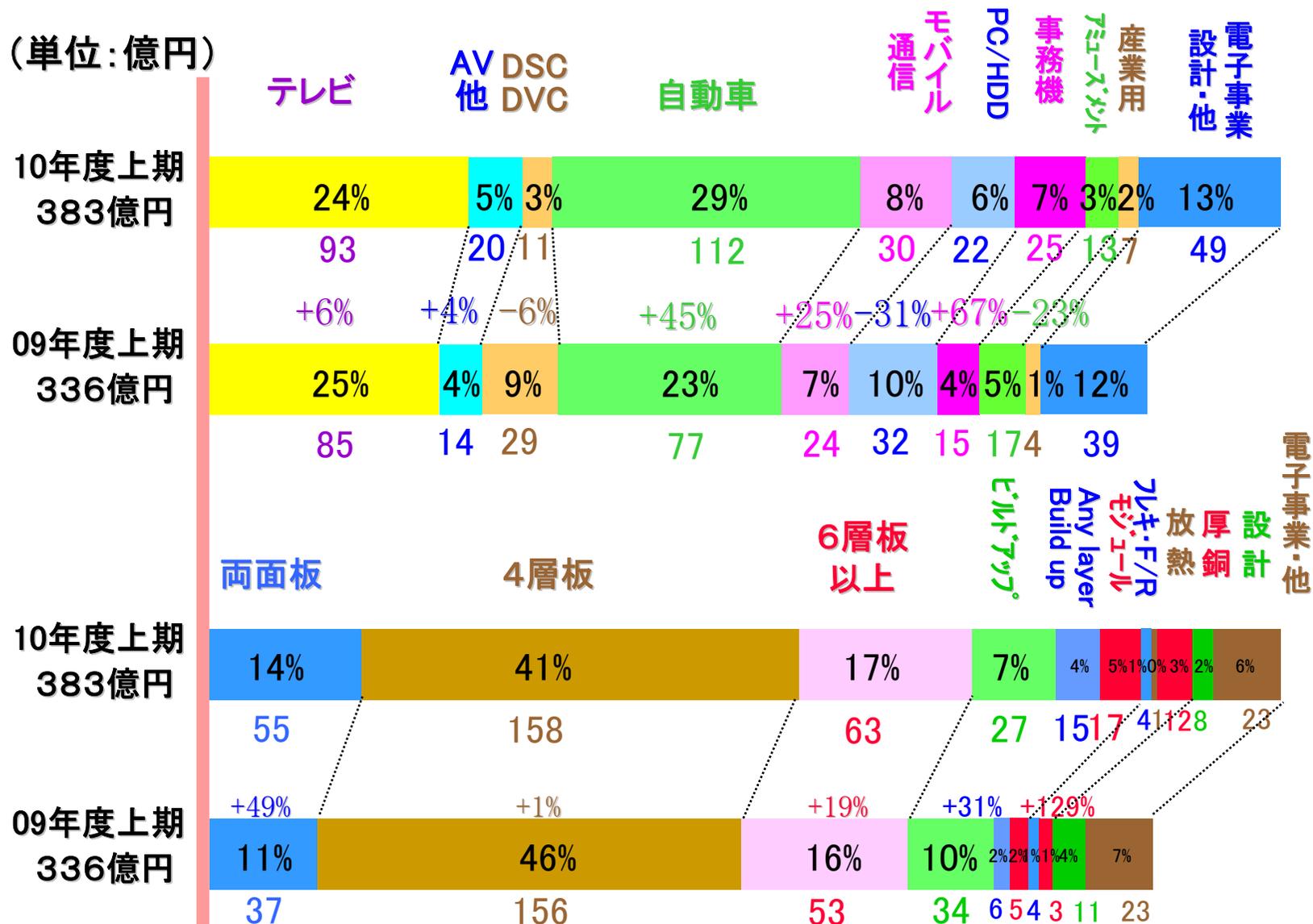
(単位:百万円)

		09年度実績	前年比	10年度実績	前年比
広州	売上高	13,710	-24.4%	16,172	18.0%
	営業利益	1,283	-36.3%	1,132	-11.8%
	営業利益率	9.4%		7.0%	
武漢	売上高	10,219	-13.3%	13,020	27.4%
	営業利益	1,818	-4.3%	1,125	-38.1%
	営業利益率	17.8%		8.6%	
宮城	売上高	1,694	-33.3%	2,617	54.4%
	営業利益	-1,015	-16.2%	-405	150.6%
	営業利益率	-59.9%		-15.5%	

1-5 事業の種類別 上期売上高



1-6 商品・品目別 上期売上高



2. 2010年度の通期見通し

	Page
2-1. 当期の取り組み	10
2-2. 連結見通し	11
2-3. 単独見通し	12
2-4. 主な関連部門見通し	13
2-5. 設備投資 予定	14
2-6. Cash Flow	15

2-1 当期の取り組み

- ☆重点課題
 - ・新規取組基板への対応
- ☆海外事業
 - ・武漢第二工場の早期立上
 - ・ベトナム工場の早期立上
- ☆国内事業
 - ・新規基板・高付加価値品の確保
- ☆仕入部門
 - ・主材(銅)高騰への対応
- ☆その他
 - ・為替(ドル・元)対応

2-2 連結通期見通し

(単位:百万円)

	2008年度	前年比	2009年度	前年比	2010年度	前年比
売上高	75,806	-3.5%	69,823	-7.9%	79,000	13.1%
営業利益	1,760	-75.9%	3,793	115.5%	5,300	39.7%
営業利益率	2.3%		5.4%		6.7%	
経常利益	953	-86.1%	2,695	182.6%	4,200	55.8%
経常利益率	1.3%		3.9%		5.3%	
当期純利益	522	-90.7%	1,828	250.0%	2,800	53.1%
当期純利益率	0.7%		2.6%		3.5%	
1株当り当期純利益	30.71円		107.39円		150.48円	

想定レート:82円/US\$ 6.6RMB/US\$

2-3 单独見通し

(単位;百万円)

	2008年度	前年比	2009年度	前年比	2010年度	前年比
売上高	44,043	3.1%	43,135	-2.1%	46,400	7.6%
営業利益	732	-55.8%	370	-49.4%	2,500	575.7%
営業利益率	1.7%		0.9%		5.4%	
経常利益	1,359	-45.1%	841	-38.1%	1,800	114.0%
経常利益率	3.1%		1.9%		3.9%	
当期純利益	180	-82.5%	-777		1,500	293.1%
当期純利益率	0.4%		-1.8%		3.2%	
1株当り当期純利益	10.6円		▲45.7円		88.33円	

想定レート:82円/US\$ 6.6RMB/US\$

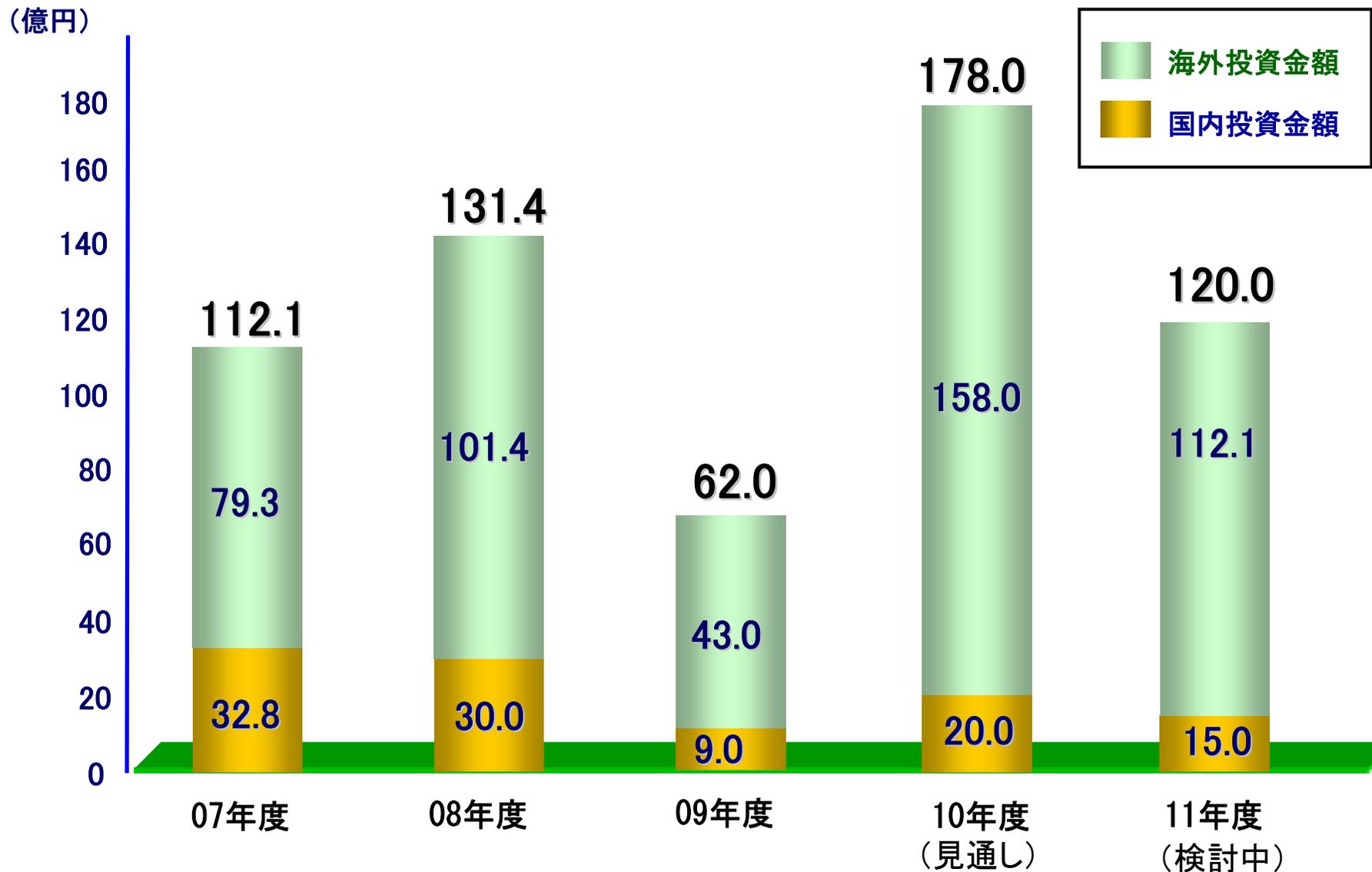
2-4 主な関連部門見通し

(単位:百万円)

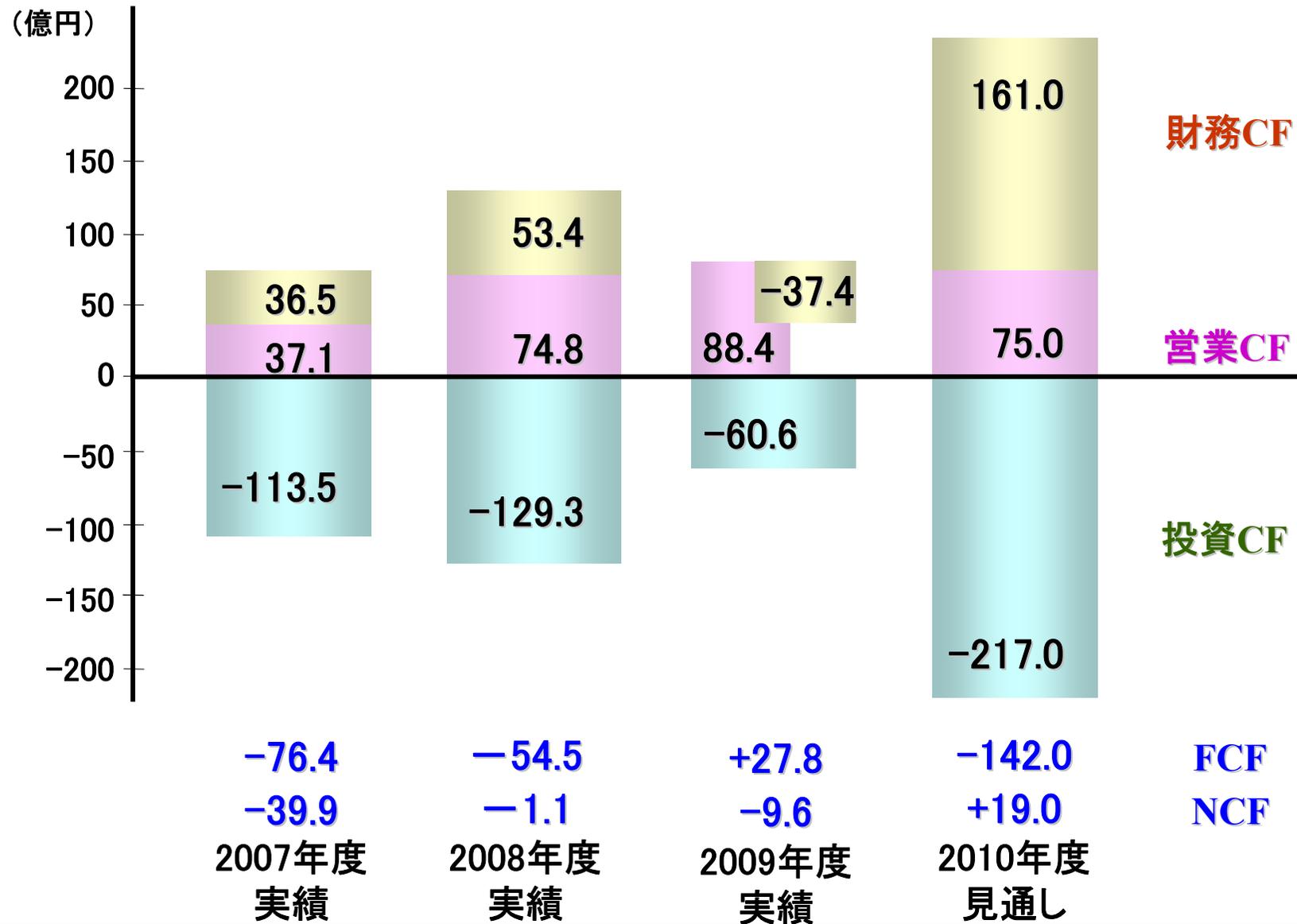
		2008年度	前年比	2009年度	前年比	2010年度	前年比
広州	売上高	27,879	-26.4%	27,811	-0.2%	31,900	15%
	営業利益	2,141	-64.0%	2,664	24.4%	2,460	-8%
	営業利益率	7.7%		9.6%		7.7%	
武漢	売上高	17,169	25.1%	21,331	24.2%	27,900	31%
	営業利益	2,518	14.3%	2,852	13.3%	3,230	13%
	営業利益率	14.7%		13.4%		11.6%	
宮城	売上高	4,253	24%	3,799	-10.7%	5,720	51%
	営業利益	-1,731	6%	-1,521	13.8%	-400	280.3%
	営業利益率	-40.7%		-40.0%		-7.0%	

想定レート:82円/US\$ 6.6RMB/US\$

2-5 設備投資見通し



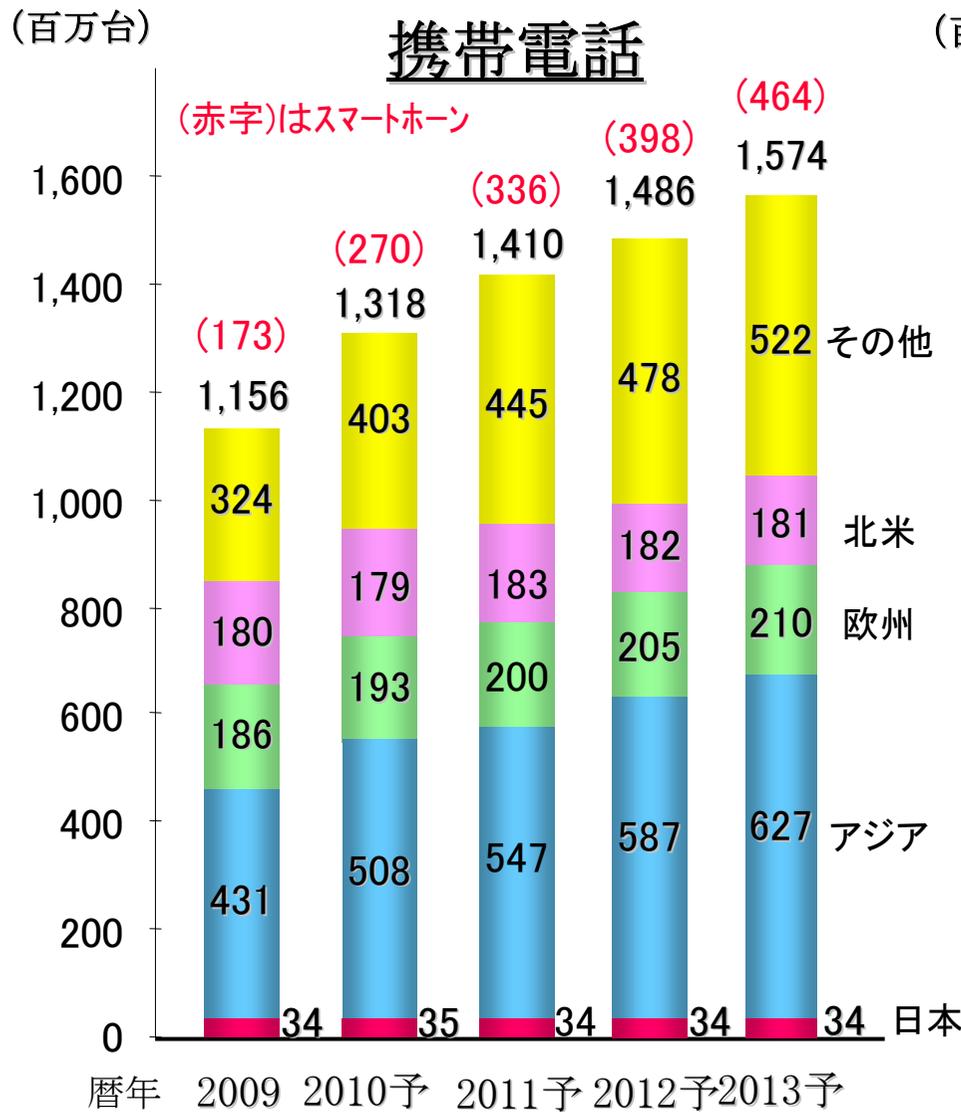
2-6 Cash Flow



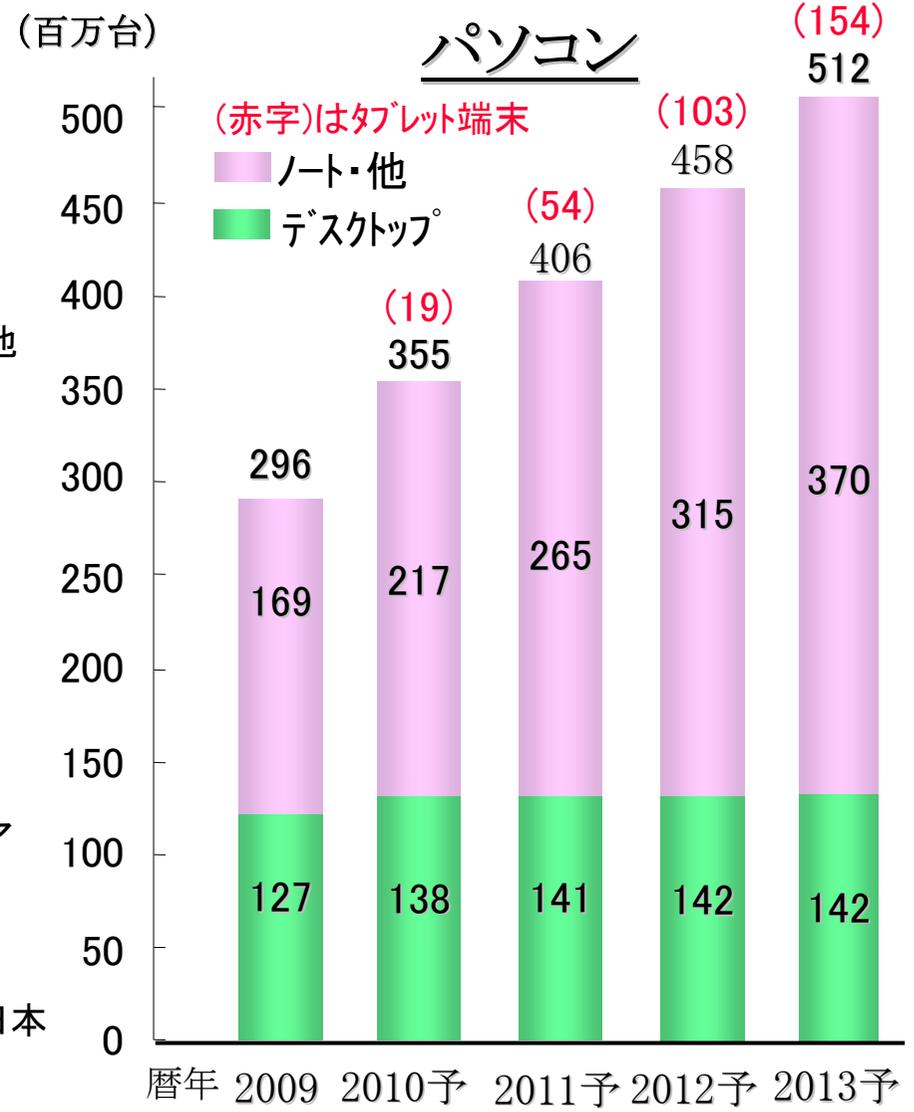
3. 今後の展望

	Page
3- 1. 世界市場(1)携帯電話、パソコン	17
3- 2. 世界市場(2)FTV、LED商品	18
3- 3. 世界市場(3)電気自動車、太陽電池	19
3- 4. 中期計画(市場別)進捗確認	20
3- 5. 中期計画(基板別)進捗確認	21
3- 6. 中期計画(顧客別)進捗確認	22
3- 7. モジュール基板	23
3- 8. 大電流基板	24
3- 9. アルミベース放熱基板	25
3-10. 宮城工場の方向性	26
3-11. 武漢第二工場立上状況(1)	27
3-12. 武漢第二工場立上状況(2)	28
3-13. ベトナムPCB工場	29
3-14. シュバイツア社との提携	30

3-1 世界市場出荷台数(1)

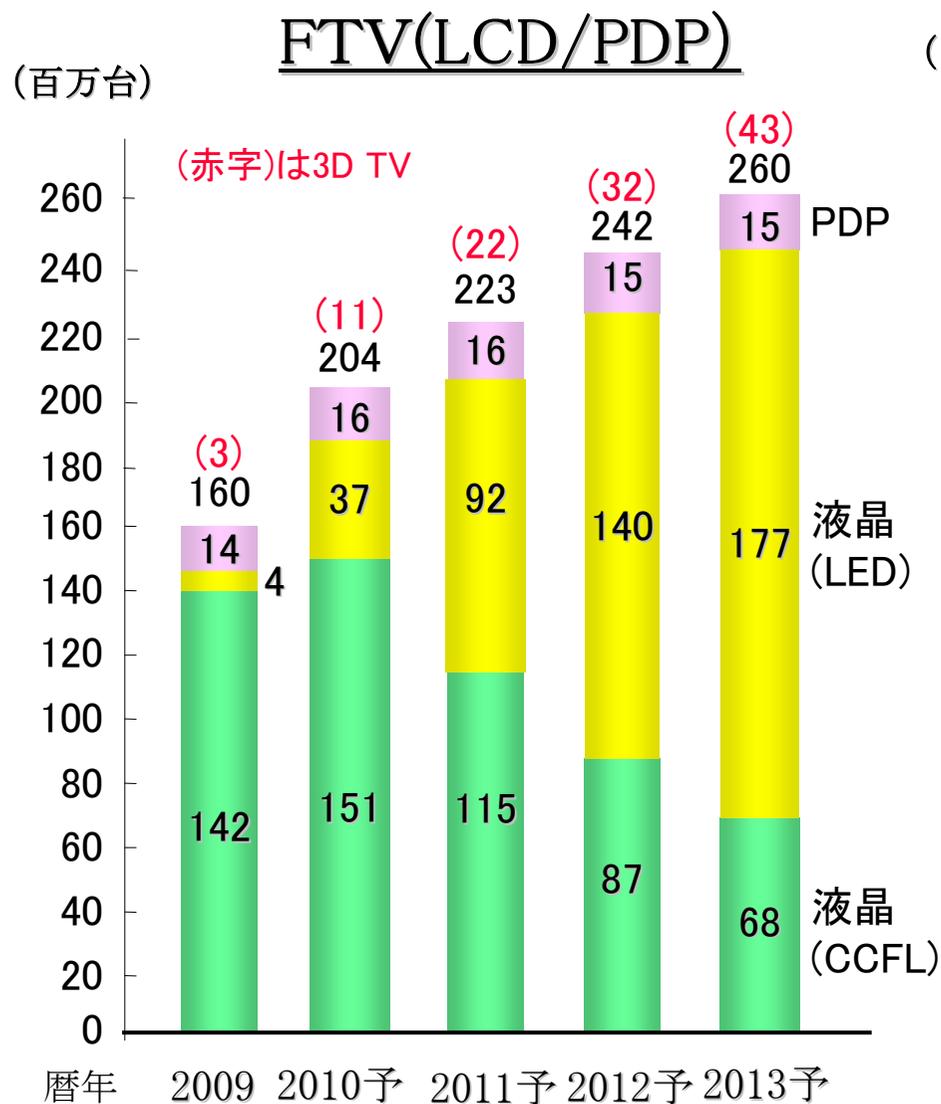


(出典: IDC, Sep.2010)

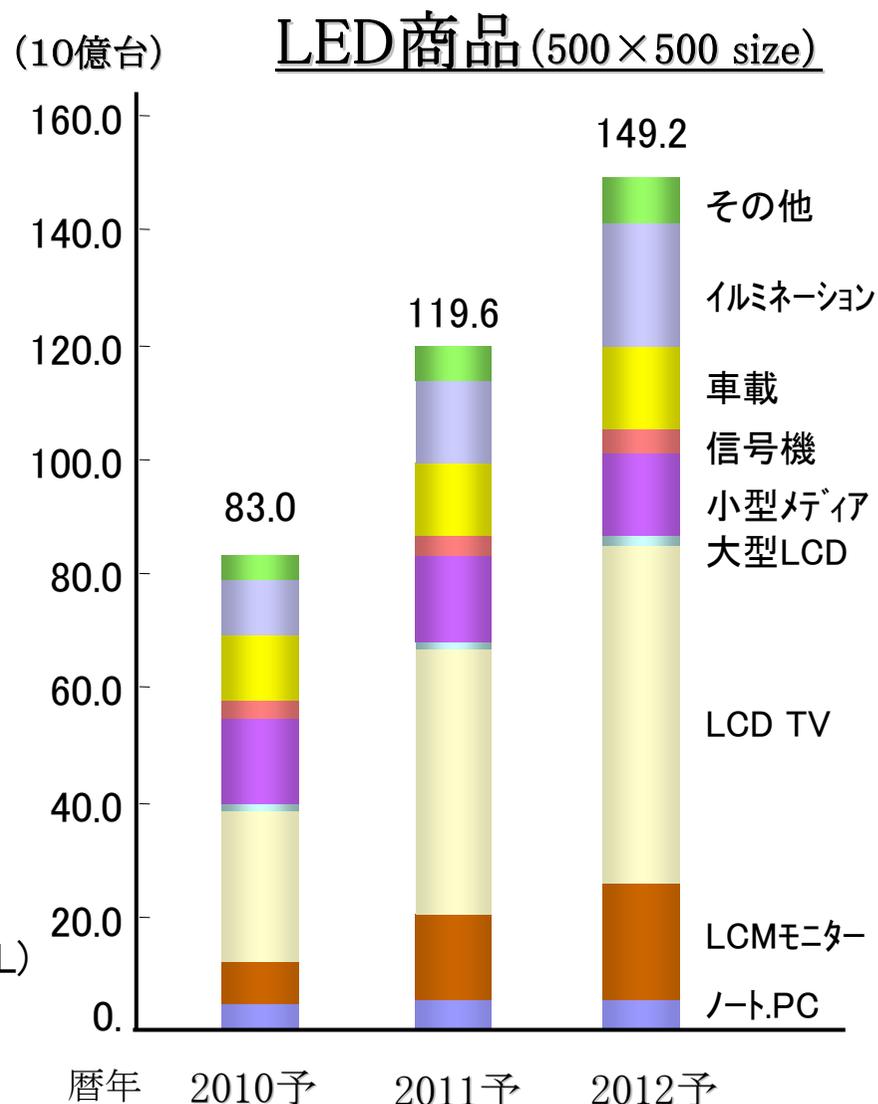


(出典: IDC, Sep.2010 Gartner)

3-2 世界市場出荷台数(2)

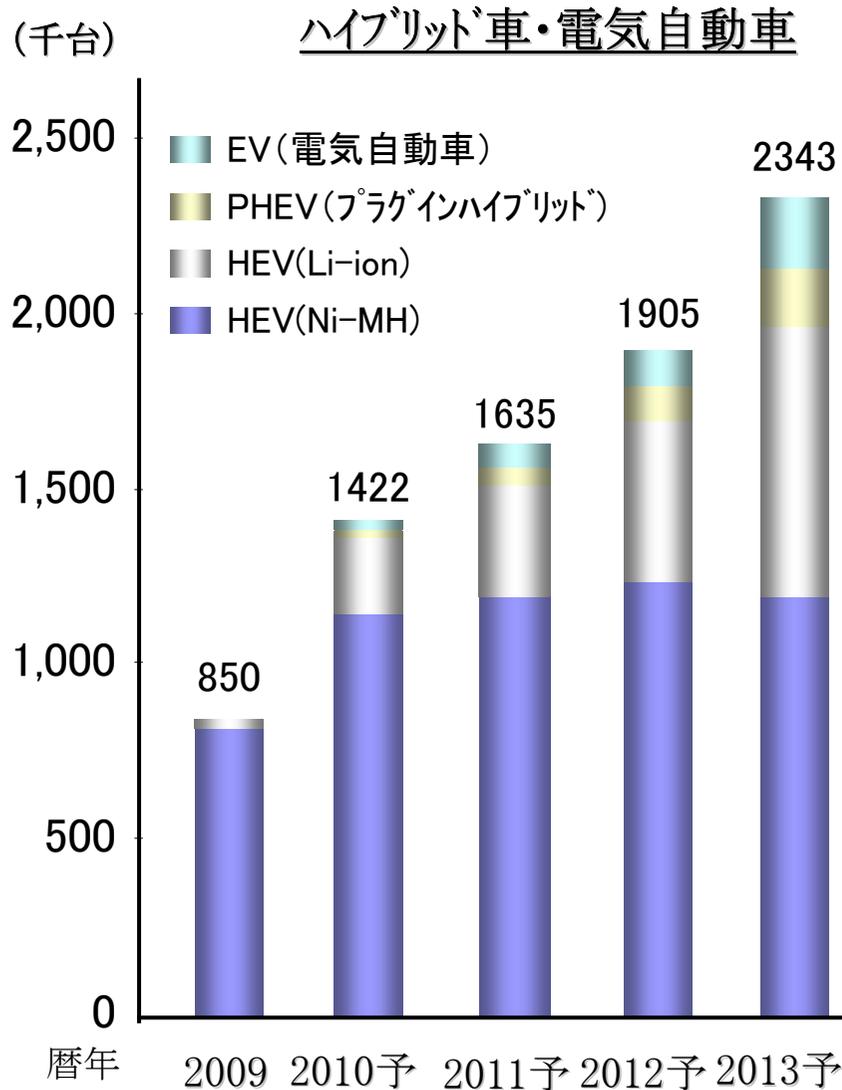


(出典:Display Search,Jul.2010)

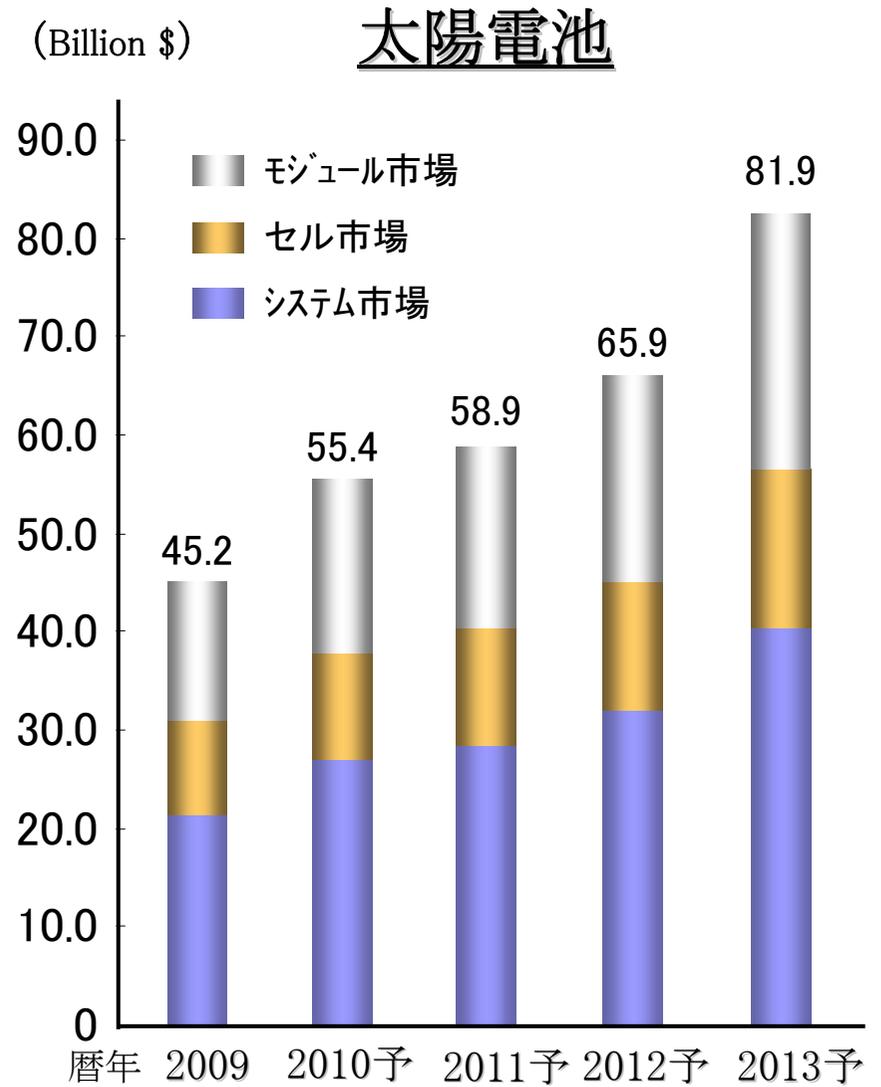


(出典:Display Search,Jul.2010)

3-3 世界市場出荷台数(3)



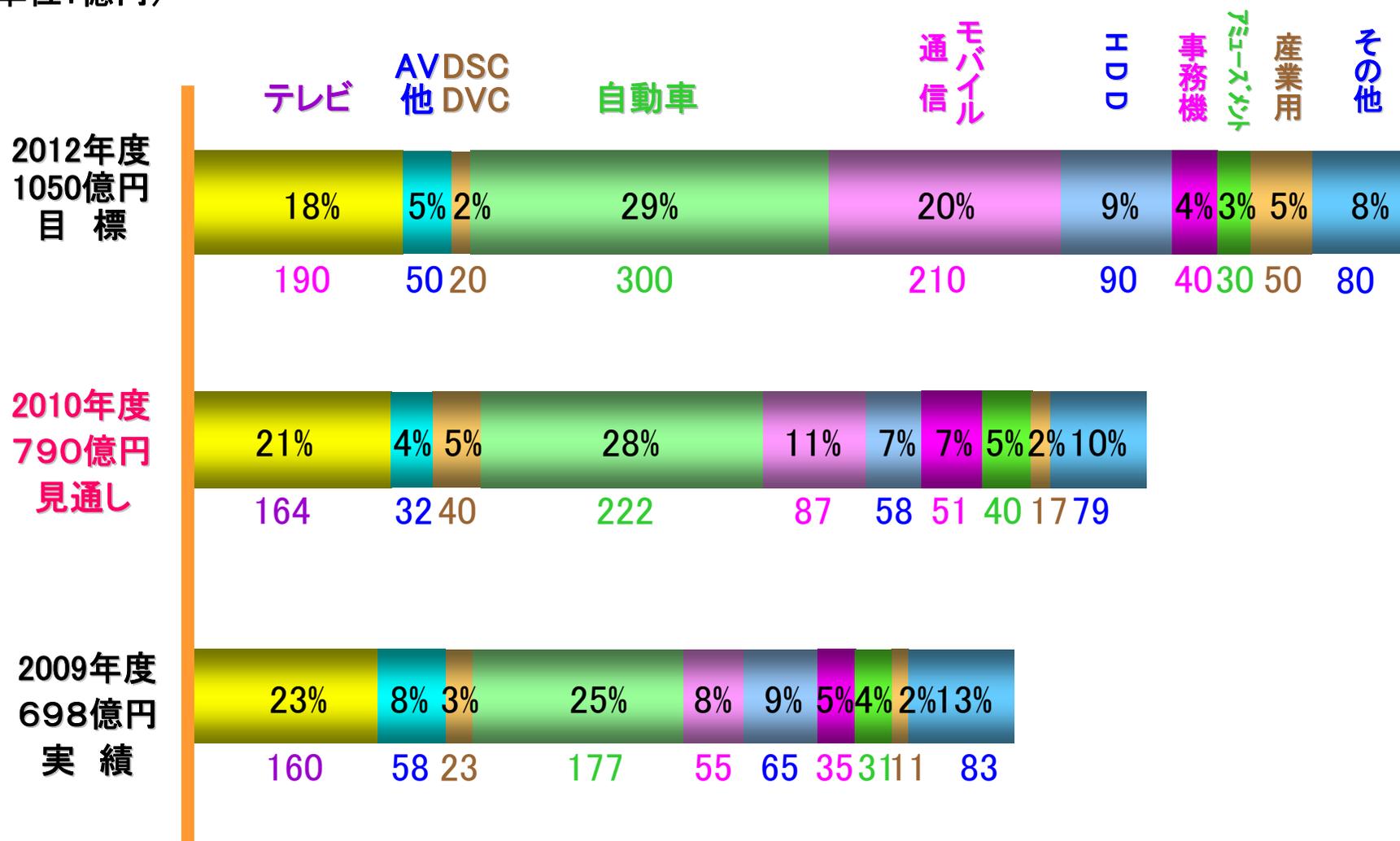
(出典:大和証券CMアナリストレポート 2009.11)



(出典:大和証券CM 2010.6)

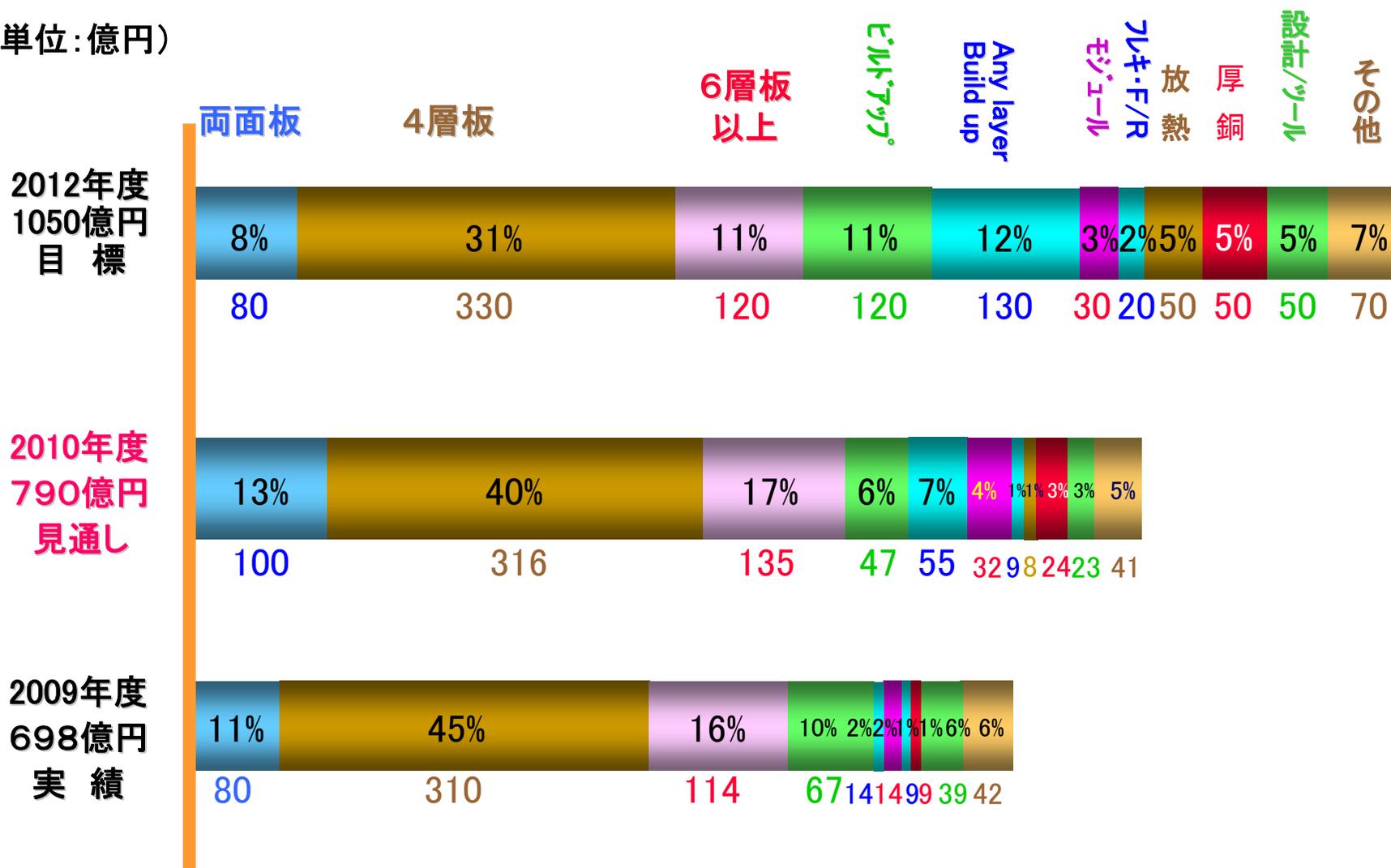
3-4 中期計画(基板市場別)

(単位:億円)

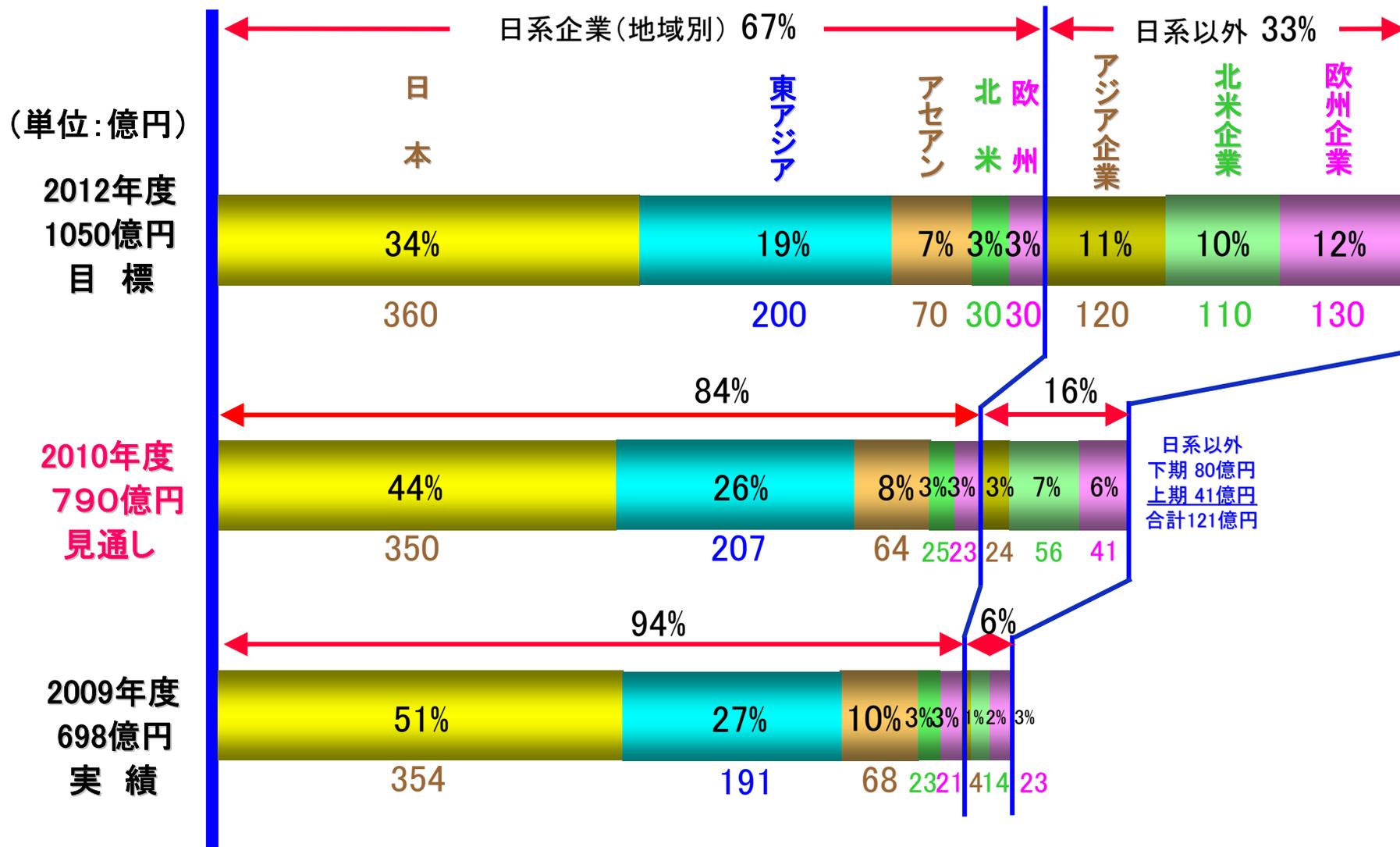


3-5 中期計画(基板品目別)

(単位:億円)



3-6 中期計画(海外顧客)

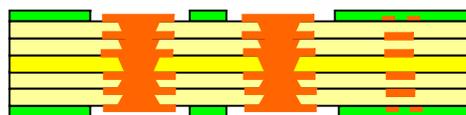


3-7 モジュール基板

Anylayer、薄型、高密度配線の基板技術応用

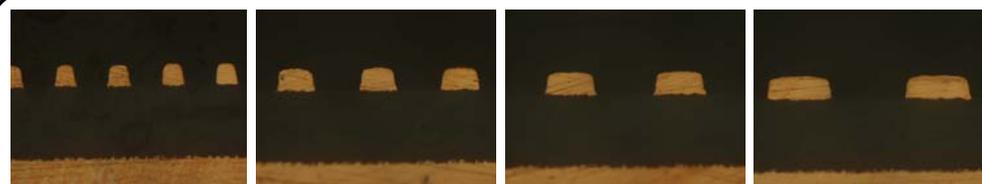
- ・BT/W-LAN/GPSモジュール、小型モバイル機器SIP/POPに展開
- ・フィルドめっきスタック構造と微細配線形成

基板構造と仕様



項目	仕様(μm)	
L&S	40/40	
レーザービア径	75	
レーザーパッド径	180	
SRダム幅	75	
導体厚み	15	
HDI厚み	35	
コア厚み	35	
板厚	4層	185
	6層	285

断面写真例



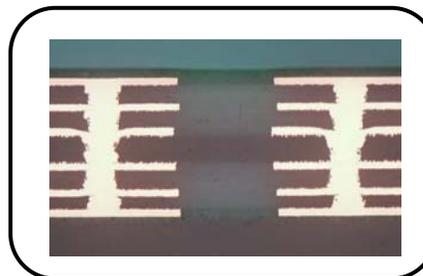
LS=20/20 μm

LS=30/30 μm

LS=40/40 μm

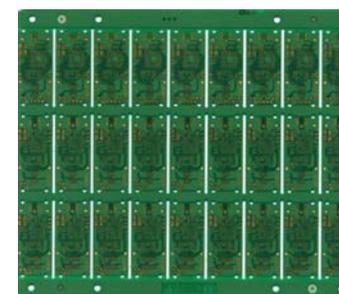
LS=50/50 μm

微細配線形成



めっき接続スタックビア

外観写真例



BTモジュール基板

3-8 放熱基板

市場: LED化が進むTV用エッジライト・照明用途

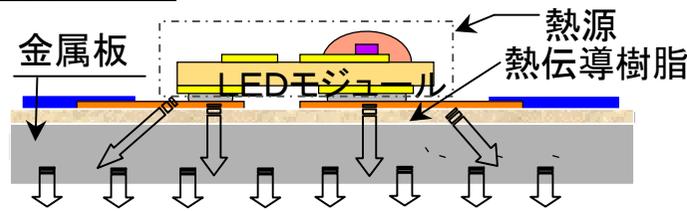
車載市場向け電動パワーステ・DC/DCコンバータ

開発: * 高信頼性放熱基板(車載用途EPS)

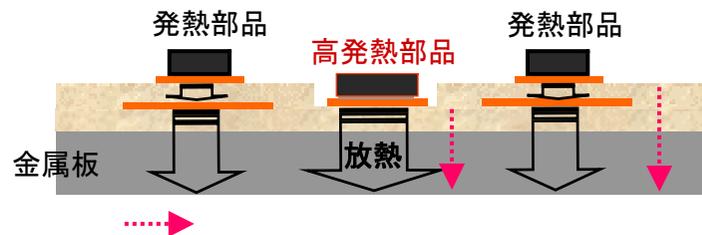
* 複層放熱基板

* 高放熱基板

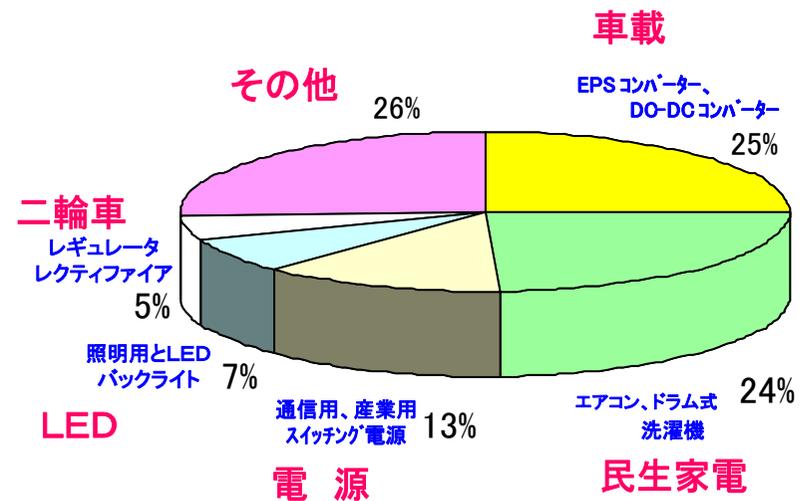
応用事例(LED用)



応用事例(車載用)



放熱基板応用分野



3-9 大電流基板

市場：Liイオン電池・ハイブリッド電気自動車・スマートグリッド

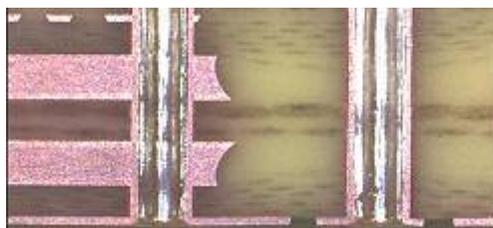
多様な電流での使用を可能にする厚銅対応（70～420 μ m）

制御基板、電送基板を一体化する同一層異種銅厚基板

電送性、放熱性を兼ね備える銅コア基板

超厚銅基板

420 μ m



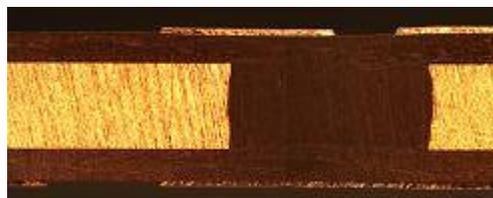
同一層
異種銅厚基板

70/200 μ m



銅コア基板

500 μ m



太陽電池・スマートグリッド



Liイオン電池

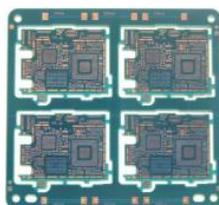


HV・EV

3-10. 宮城工場の方向性

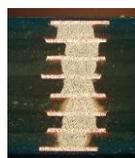
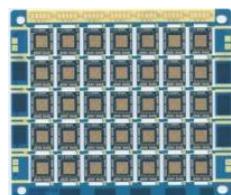
☆スマートホーンの専用工場化 5km²/月

メイン基板
(10層Anylayer構造)



☆モジュール基板の専用工場化

カメラ用



通信用



* 通常ビルドアップ基板は
順次山形工場へ移管



3-11 武漢第二工場立上状況(1)

* スマートホン用10層Anylayer 基板

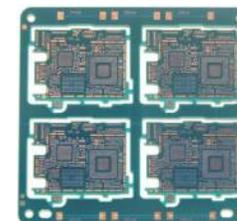
2010年10月-12月 4km²/月

2011年 1月- 3月 8km²/月

2011年 4月- 6月 10km²/月

2011年 7月- 9月 20km²/月

: :



* ゲーム用ビルドアップ基板

2010年11月-12月 10km²/月

2011年 1月- 3月 15km²/月

: :



第二工場

3-12 武漢第二工場立上状況(2)

* LED用アルミベース放熱基板

2011年2月ー 10km²/月

2011年5月ー 20km²/月

2012年3月ー 50km²/月

： ー



* 車載・スマートグリッド用大電流基板

2010年12月ー 10km²/月

2012年 3月ー 30km²/月

： ー



3-13 ベトナムPCB工場立上状況

*携帯電話用HDI基板

2010年11月外形加工 3km²/月

2011年 6月一貫生産 10km²/月

2011年10月一貫生産 20km²/月

* 多層貫通基板

2011年5月 40 km²/月



3-14 シュバイツァー社との提携

＜シュバイツァー社概要＞

- ・設立: 1849年
- ・CEO: Dr. Mark Schweizer (6代目)
- ・所在地: ドイツ シュラムベルグ (Schramberg) 市
- ・従業員: 744名
- ・売上高: 2010年130百万ドル (見込) 2009年113百万ドル
- ・顧客: 車載56%、スマートグリッド24%、産業用15%、他5%
- ・基板構成: 両面32%、4・6層37%、HDI 21%、他10%

＜弊社提携のメリット＞

- ・シュバイツァー社の欧州での販売・サービスの活用
- ・欧州車載機器・産業機器の拡大
- ・スマートグリッド・電池インバーターの拡大
- ・中国生産での付加価値拡大

SCHWEIZER
ELECTRONIC





株式会社メイコー

<http://www.meiko-elec.com/>

2010年11月18日